



半導体後工程大手の台湾力成科技、テラプローブ<6627>をTOBにより子会社化



半導体組立・検査を手がける台湾の力成科技股份有限公司（パワーテック、新竹市）は、テラプローブに対して子会社化を目的にTOB（株式公開買い付け）を実施する。テラプローブはTOBに賛同すると発表した。テラプローブの東証マザーズへの上場は維持される。パワーテックはテラプローブの顧客基盤を活用し、日本の車載半導体メーカーやIoT（モノのインターネット）関連製品メーカーとの取引拡大を見込む。買付代金は最大で約90億2500万円。

買付価格は1株あたり1100円。買付予定数は820万5255株で、下限は所有割合39.65%にあたる368万株。買付期間は2017年4月17日から5月29日まで。決済の開始日は6月5日。

パワーテックは半導体製造後工程の受託会社で、売上規模は世界第5位。テラプローブの株式11.6%を所有しており、東芝やIntel Corp.（カリフォルニア州）、テラプローブの筆頭株主であるマイクロンメモリジャパン（MMJ、東京都中央区）の米国親会社、Micron Technology, Inc.（アイダホ州）などを主要顧客とする。

MMJは所有するテラプローブの株式39.65%についてTOBに応募することで合意している。